

SD628T A&B

高热导型有机硅电子灌封胶

简介

SD628T 是有机硅加成型灌封胶。产品是由 A, B 双组分构成, 当 A 和 B 组分以 1: 1 比例混合后, 逐渐固化形成有机硅弹性体。产品在室温下就可以固化, 当加热时, 可以使固化速度加快。该产品有较好的阻燃性和热导率, 更适合于工作状态下发热的电子元器件的灌封。

产品参数

1- 固化前

固化体系加成型	
外观A组分	黑色
B组分	白色
粘度, cPA组分	25000
B组分	25000
比重, g/cm ³	2.23

2- 固化

SD628T A、B组分混合之后就开始固化。

配比 (体积或质量)	1:1
凝胶时间, 分钟	40
起始粘度, cP	25000
加热70°C固化时间, 分钟	<30
常温 (20-30 °C) 固化时间, 小时	4~16

3- 固化后

比重, g/cm ³	2.23
硬度 (邵氏A)	10
10%延伸时的模量, MPa	0.4
拉伸强度, MPa	0.7
断裂伸长率, %	300
热导率, W/mK	>1.4
体积电阻率, Ω.cm	5.7×10 ¹⁴
介电常数	2.9
介质损耗角正切	1.4×10 ⁻³
击穿电压, KV/mm	16
环保认证	Rohs
阻燃级别	UL94V0 (File:E340343)

使用说明

1. 所有的基材表面必须干净和干燥，没有灰尘和油腻以及其他任何影响产品正常固化和粘结的物质。
2. 将 A, B 组分打开包装，搅拌预混后，按 1: 1 的重量比称取。
3. 将按比例配好的 AB 组分充分混合，真空脱气后，立即灌入需要灌封保护的电子器件中。
4. 让灌封胶在室温环境下，或加温的环境下固化。
5. 未经混合的灌封胶一旦包装开封后，建议尽早使用完毕。如有剩余，需密闭储存，尽量减少与空气中水分的接触。

使用注意事项

- A. 灌封胶在储存期间会产生部分沉降。因此，使用时要将底部搅起，与上部浮油混合，然后以 1:1 比例使 A 和 B 混合。
- B. 混合后的硅胶在 25 °C 下只有大约 40 分钟的工作时间。超过 40 分钟，硅胶可能过稠甚至固化，导致无法灌封。
- C. 不同温度下，灌入元件的硅胶其完全固化时间有较大差异，
25°C 需要 ~4 -16 小时
70°C 只需要 0.2 小时
10°C 可能需要 2-3 天
- D. 有些化学物质可能造成硅胶中催化剂的中毒，导致固化时间增长或无法固化。比如：含硫的化合物，含胺基的有机物，烯烃或炔烃等等。

储存与产品保质期

未经开封的 SD628T 产品可以存储在室温下 12 个月。产品一旦开封应当尽早使用完。

安全

请参考本产品 MSDS。

告用户

本文中的资料是依据欧赛尔（苏州）新材料股份有限公司现有测试手段和测试结果的真实表述。然而，由于每个应用都有其独特性，本产品资料决不能代替用户在试用前进行必要的测试。用户的测试结果是唯一确保本产品适合其特定的应用要求。因此，除非欧赛尔（苏州）提供书面保证，否则，欧赛尔（苏州）新材料股份有限公司只保证该产品符合其出厂质检规格。欧赛尔（苏州）也不认可任何其它形式的保证和索赔条款。如果出现任何产品质量上的问题，欧赛尔（苏州）有权对产品品质进行再次测试。一旦确认是欧赛尔（苏州）的产品问题后，欧赛尔（苏州）仅限于对有问题产品提供更换或退还销售金额。用户应负责保证遵守当地安全法规并获得必需的证书和认可。对使用中出现的安全问题和损失，欧赛尔（苏州）不承担任何责任。用户应复核他们拥有的该产品资料是最新的版本，欧赛尔（苏州）新材料股份有限公司可按用户的要求提供任何附加的资料。本产品资料有中文和英文版本，如有出入，以英文文本为标准

欧赛尔（苏州）新材料股份有限公司